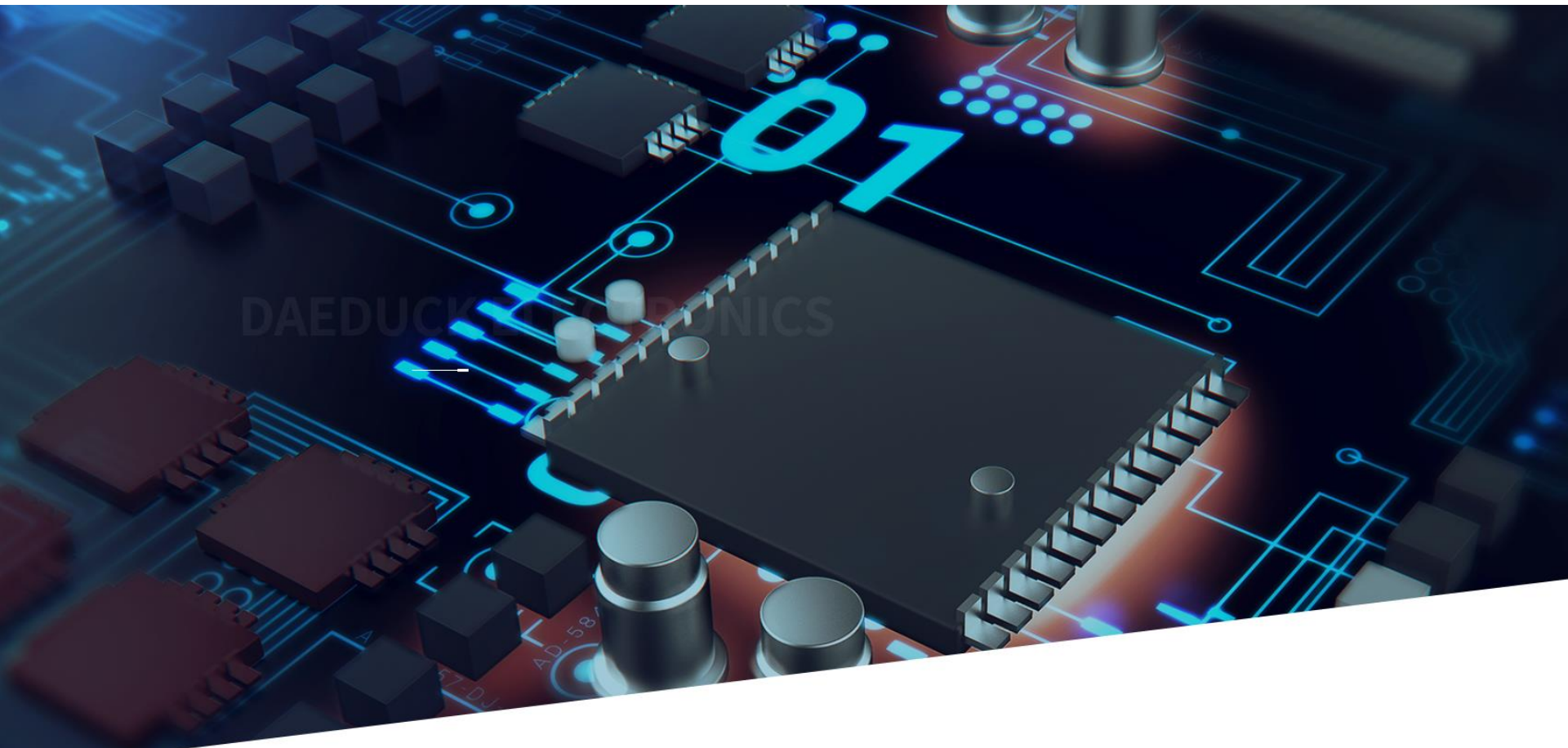




대덕전자 (주)

2020년 2분기 경영실적

2020.8

Disclaimer

본 자료는 투자자의 투자판단을 위한 참고자료로 작성 된 자료 입니다.

당사는 5월 1일을 기준으로 회사가 분할 되어 신규설립 됨에 따라,

공시기준으로는 5월이후에 해당하는 2개월분의 실적이 확인됩니다.

그러나, 사업회사의 경영은 지속되고 있음을 감안하여, 기존 투자자들의 편의를 도모코져,

실적 사항은 분할 전 실적을 포함한 사업 연속성 기준으로 작성 되었습니다.

또, 본 자료에서 미래에 대한 예측 정보는 투자자 편의를 위한 참고사항으로,

향후 경영환경과 시장의 변화에 따라 차이가 발생할 수 있음을 양해 바랍니다.

당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

또한 당사는 투자자 여러분의 독립적인 판단에 의하여 투자가 이루어 질 것으로 신뢰합니다.

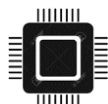
본 자료의 재무자료는 K-IFRS 개별 기준 입니다.

회사개요 및 사업소개

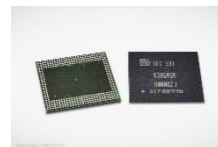
[회사개요]

회사명	대덕전자 (주)
대표	신영환
설립일	2020년 5월 1일 (회사분할) ※최초설립 : 1972년 8월
신규상장일	2020년 5월 21일
자산규모	7,804억
임직원수	2,550명
본사위치	경기도 안산시 단원구 강촌로 230
해외거점	대덕 베트남 (FPC) 대덕 필리핀 (MLB)

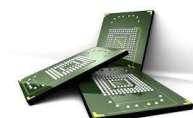
[사업소개]



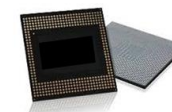
PKG 부문



DRAM



Nand



AP / Controller

· 메모리 및 비메모리 用 반도체 Package 기판



Mobile 부문



Wearable



Camera Module



Flexible Cable

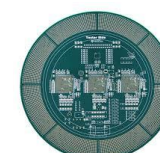
· 5G Mobile用 (C/M, Wearable, Cable用) Rigid-Flex 기판



MLB 부문



5G Repeater



Probe Card



ADAS, Telematics

· 5G Network 장비 및 반도체 Tester, 전장用 MLB 기판

'20년 2분기 실적

매출 : 서버 및 DATA센터向 PKG매출 호조, Covid-19영향에 따른 스마트폰 등 전방시장 침체로 FPC 및 Network 실적둔화. HDI사업중단으로 매출감소, 전장 Product Mix 개선에 따른 매출감소
전분기 대비 -8%, 전년동기대비 -22% 감소

수익 : PKG실적은 1분기 대비 호조세를 기록 했으나, 스마트폰 등을 전방으로 둔 모바일, MLB 등은 코로나 영향으로 시장둔화에 따른 수주감소로 고정비 부담 증가. 전분기대비 -12% 감소, 전년동기대비 -60% 감소

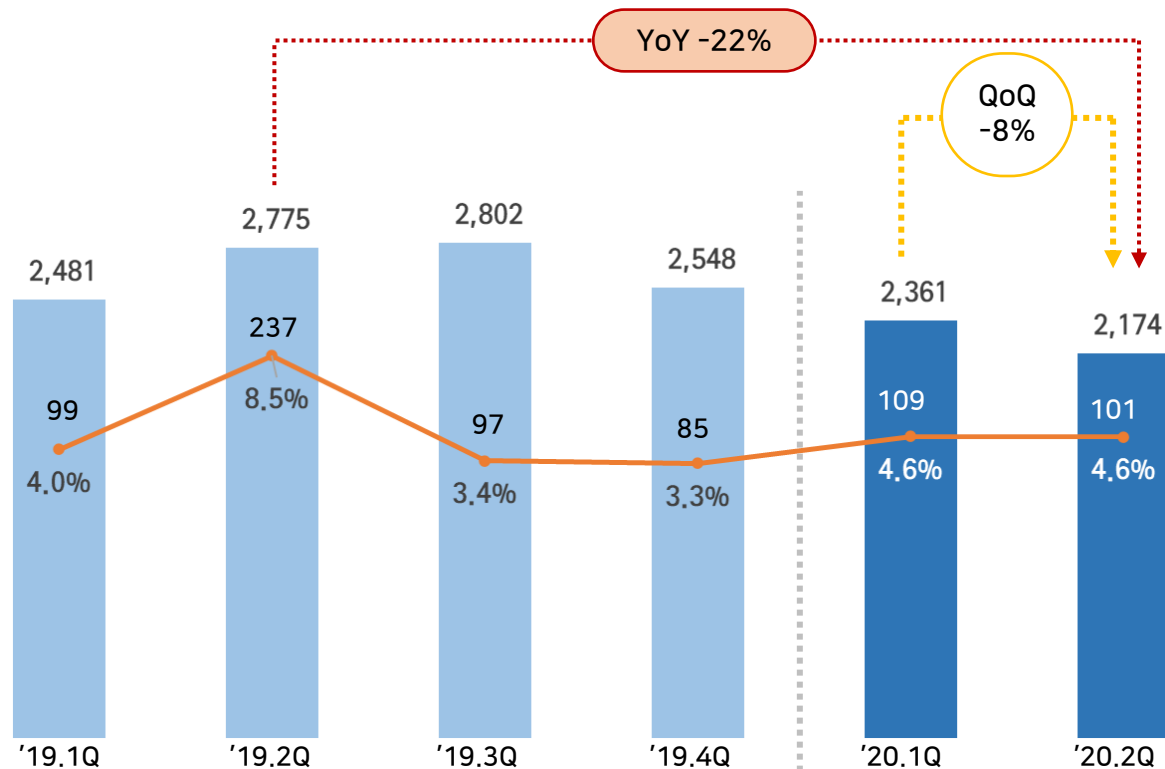
[분기별 매출액 및 영업이익 추이]

단위:억원, %

■ 매출액

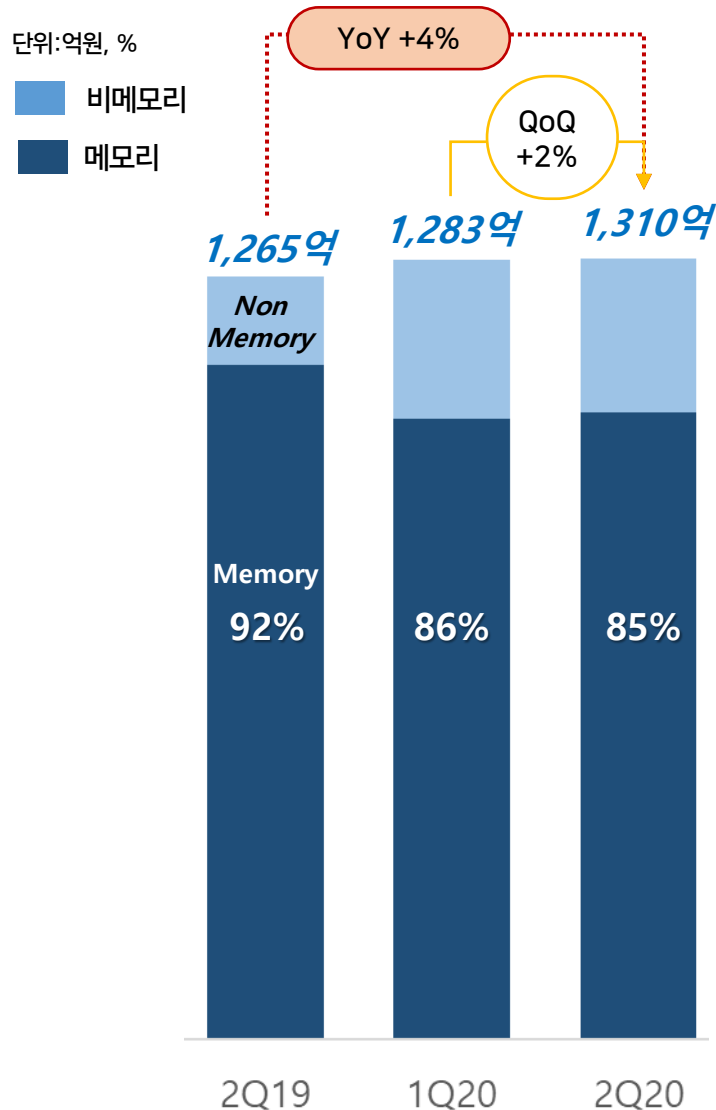
—●— 영업이익(율)

[별도기준]



※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

PKG부문 - '20년 2분기 실적 및 '3분기 예상



['20년 2분기 실적]

글로벌 침체 불구 선전

- 코로나 확산에도 높은 시장수요를 배경으로 호실적 달성
- 서버 및 DATA센터向 FC-BOC, FC-CSP 매출 증가세
- 모바일向 물량의 부분감소를 Notebook 등 '언택트 수요'의 증가로 상쇄

['20년 3분기 예상]

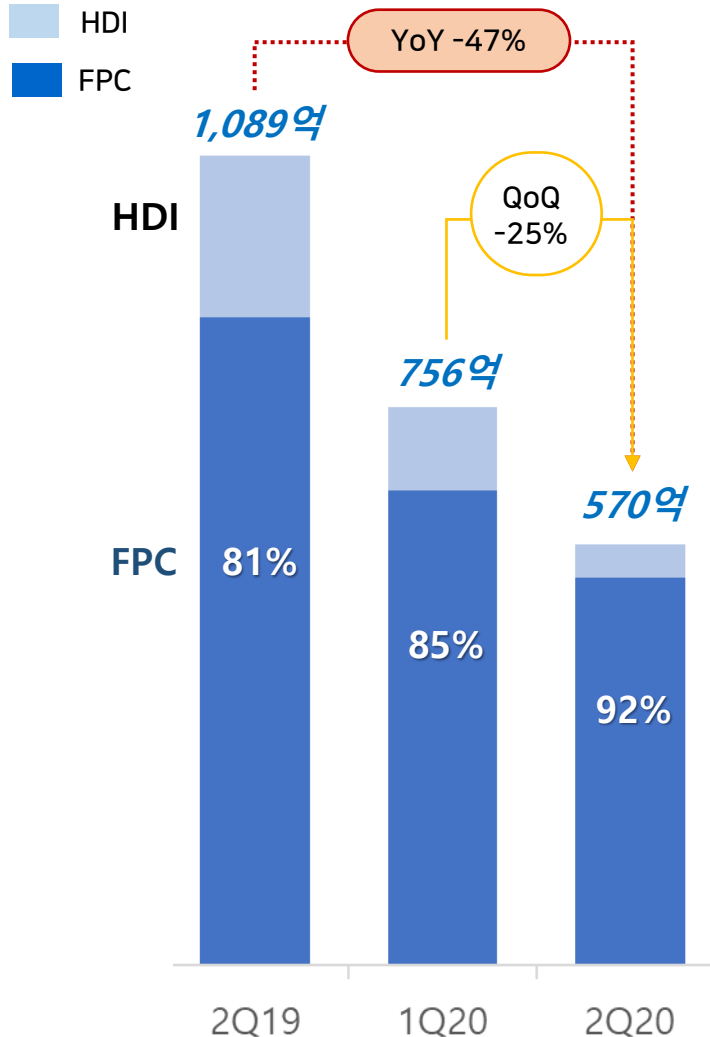
연말까지 지속 성장세 유지

- 고객사 수요충족 및 시장가격 하락 등 예상
신규고객사 및 모델을 통한 실적유지 전망
- 하반기 중 DDR5, GDDR6 본격 출시에 따른 실적개선 기대
- 비메모리 중심의 신규모델 확대
- FC-BGA 투자진행을 통한 신성장 동력 구축

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

Mobile부문 - '20년 2분기 실적 및 '3분기 예상

단위: 억원, %



['20년 2분기 실적]

전방시장 급감으로 고정비 부담 가중

- Covid-19에 따른 시장 침체에 따른 주력 고객사向 물량 급감 및 경쟁심화에 따른 ASP 하락
- HDI (메인기판) 사업 중단으로 경영손실 최소화
HDI 공장 內 SLP(Substrate Like PCB) 생산설비의 활용을 통한 FC-BGA 공장으로 전환추진

['20년 3분기 예상]

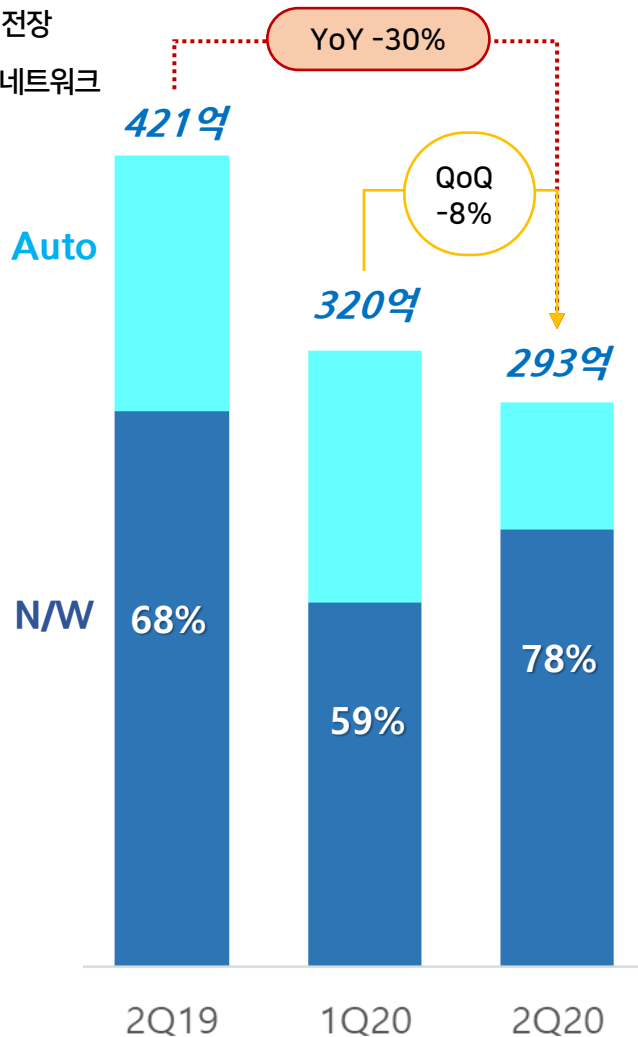
상반기와 대비 실적개선 기대

- 주력 고객사向 플래그십 수주물량 증가로 가동률 회복
- 연성기판시장內 가격경쟁 심화지속
- 글로벌 경쟁사의 물량 차질 시기에, 주력 고객사의 전략적 마케팅 강화로 상반기 대비 실적 개선전망

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

MLB부문 - '20년 2분기 실적 및 '3분기 예상

단위: 억원, %



['20년 2분기 실적]

전방시장 정체, 체질개선 추진

Network

- 글로벌 DATA 센터向 MLB물량 증가세
- 반도체 Tester 向 물량 확대

Automotive

- Covid-19에 따른 납품 차질
- Product Mix 개선을 위한 손실모델 정리 (매출감소)

['20년 3분기 예상]

수익 개선 효과 기대

Network

- 국내외 고객사 본격생산재개 및 미-중 무역마찰에 따른 반사이익으로 단계적 물량증가 기대
- 반도체 Tester용 물량 지속 증가

Automotive

- Product Mix 개선을 통한 수익개선 전망

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

요약 재무제표

[요약 재무상태표]

[단위:억 원]

	분할 전	분할 후
구분	19.12	'20.06
유동자산	5,068	2,819
현금 및 현금성자산	413	269
금융상품	1,901	6
채권 등	1,678	1,423
비유동자산	6,790	4,985
자산총계	11,858	7,804
유동부채	1,377	1,132
비유동부채	102	80
부채총계	1,479	1,212
자본금	407	257
자본총계	10,378	6,592
부채비율	14%	18%

[요약 손익계산서]

[단위:억 원]

공시 실적

구분	19.2Q	20.1Q	20.2Q	5~6월
매출액	2,774	2,360	2,173	1,470
PKG	1,265	1,283	1,310	884
Mobile	1,088	756	570	387
MLB	421	320	293	199
영업이익	237	109	101	67
(%)	8.5%	4.6%	4.6%	4.6%
세전이익	277	187	87	47
당기순이익	215	101	69	40

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

- 감사합니다 -

이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

IR GO 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.